

閎康產學合作計畫作業說明

一、計畫宗旨

為提升發展新元件與新材料研究過程中，分析檢測方面所需具備之尖端服務及品質，閎康科技結合各大學研究資源，提供高階分析儀器服務，與科技部補助之基礎研究核心設施服務中心合作推動進行相關基礎及應用產學研究，以強化研發能力，促進產業升級，創造產學雙贏。

二、申請與審查

(一) 推動期程：

自民國 110 年始至 114 年止，閎康科技預定每年投入新台幣 2,000 萬元，補助以開發高科技產品和製造、封裝、測試與系統等主題，運用先進分析檢測技術為手段之研究計畫，每年申請計畫執行期間為當年度 8/1 開始至次年 7/31 止。

(二) 辦理公開徵求：

以科技部基礎研究核心設施服務中心（台大、台師大、清大、陽明交大、中央、中興、成大、中山等八校）為合作平台，假各中心網頁與閎康科技公司官網同步公告計畫徵求，預計每年 5 月初開始受理申請，6 月 15 日截止收件。

(三) 申請人資格與方式：

計畫主持人須具備科技部專題研究計畫主持人資格，並任職於八校服務中心所在機構，每人以申請一件為限。請依附件產學計畫書格式製作文件，並依公告截止日期內將電子檔郵寄閎康科技行政窗口，計畫內容相關疑問請洽技術窗口。逾期、文件不全或不符合規定者，不予受理。

行政聯絡窗口 雷秀玲小姐, (03)611-6678 ext: 4322, JDP@ma-tek.com

技術諮詢窗口 陳弘仁先生, (03)611-6678 ext: 3250, JDP@ma-tek.com

(四) 審查與核定：

由閎康科技收件、審查與核定，各服務中心每年遴選 2~5 件，112 年度計畫核定結果最晚於 7/15 前通知各服務中心與申請人。

遴選重點：

1. 研究主題以半導體、光電材料、製造封裝等相關領域優先。
2. 具創新或未來應用發展潛力。
3. 計畫之執行建議使用閎康科技所提供之分析儀器。

補助項目由閎康科技提供下列尖端分析測試服務。

依儀器設備分為 9 大領域：

1. 非破壞性結構觀察 (3D x-ray, SAT, Thermal EMMI)
2. 微結構與成份分析 (樣品製備, 高解析 TEM, SEM, FIB, EDS, EBSD, EELS, NBD, SAD)
3. 雜質濃度檢測 (SIMS, SRP, SCM, XPS, Auger)
4. 污染與微量檢測 (TOF-SIMS, XPS, FTIR, XRF)
5. 液態 TEM 分析 (K-kit)
6. 元件級電性量測與缺陷定位 (C-AFM, Nano-probing, EBIC/EBAC, PEM, OBIRCH, Thermal EMMI)
7. ESD (HBM, MM, CDM, Latch-up, TLP, EOS)
8. 可靠度測試 (HTOL, HAST, TCT, BLT, TS, Vibration, Shock, H₂S corrosion, AMR/AMI, HRTB, ...etc.)
9. 物理化學分析 (ICP-MS, TGA, LC-MS, ...etc.)

三、經費補助

審查通過之計畫，閎康科技得要求計畫主持人提供詳細之實驗內容與步驟，商訂補助之經費，計畫的預算配比如下：

- 70% 設備使用費（閎康科技貴儀）
- 20% 學校管理費
- 10% 人事、材料及其他業務費用

四、簽約

依執行機構產學計畫相關規定辦理。

1. 雙方確認合約(閎康提供，校方確認)。
2. 閎康(甲方)用印完成後，寄給校方(乙方)用印。
3. 校方(乙方)寄回一份雙方皆用印完成之合約，並附上收據予閎康(甲方)。

五、執行

- (一) 計畫主持人需提供至少期初計畫、期中進度報告與期末進度報告，計畫執行期間可隨時與閎康科技討論研究方法與進度。
- (二) 閎康科技就每個計畫安排一位專案人員(PM)，負責接洽收送件與技術討論事宜。